

investor

newsletter

IM FOKUS

- 2-3 ■ Das Ein-Quadratzentimeter-High-Tech-Labor

TRENDS & THEMEN

- 4-6 ■ Ein Wettlauf im Schweinezyklus
■ Infineon „Offizieller Lieferant“ von Ferraris Formel-1-Team
■ Infineon beschleunigt Konzernumbau
■ Matthias Poth neuer Leiter des Corporate Center von Infineon

ENTWICKLUNG & PRODUKTE

- 7 ■ Joint Venture soll Weg in Wachstumsmarkt Flash-Speicher ebnen
■ Herausragende Ergebnisse von Infineon-Forschern
■ Leistungssprung: Neuer VDSL-Chipsatz mit hohen Datenraten
■ Probelauf für Chip-Strukturen unter 50 Nanometern

ZAHLEN & FAKTEN

- 8-11 ■ Erneut Umsatzanteile gewonnen
■ Zur weiteren Stärkung der Finanzkraft: Infineon begibt Wandelanleihe
■ Infineon stärkt Sensorengeschäft der Automobilsparte

AUSBLICK

- 12 ■ Ausblick auf die zweite Hälfte des Geschäftsjahres bis 30.09.
■ Relative Performance der IFX-Aktie seit Beginn des GJ 02/03

Labor im Miniaturformat:

Biochips wie dieser Flow-Thru-Chip von Infineon könnten die Arbeit in Pharmalabors ähnlich umfassend verändern wie der Personalcomputer vor zwei Jahrzehnten die Computerlandschaft.



DAS EIN-QUADRATZENTIMETER-HIGH-TECH-LABOR

Biochips kommen Krankheiten auf die Schliche und entdecken neue Medikamente – mit genetischem Reißverschluss

Mikroelektronik und Biologie – das klingt zunächst nicht gerade nach einem Traumpaar. Und doch haben sich beide Disziplinen in den vergangenen 20 Jahren immer stärker aufeinander zu bewegt – und zwar dort, wo es jeweils um die kleinsten Bausteine der Materie geht. An den Grenzen von Physik, Chemie, Molekularbiologie und Materialwissenschaften haben sich die interdisziplinären Nanowissenschaften entwickelt. Die Mikroelektronik trifft dabei mit ihrer immer weiter verkleinerten und leistungsfähigeren Datenverarbeitung auf eine Biologie, die zunehmend in der Lage ist, Erbgut zu entschlüsseln und genetische Daten nutzbar zu machen.

Inzwischen ist die Beziehung keine rein wissenschaftliche mehr, vielmehr trägt die Liaison erste kommerziell nutzbare Früchte – beispielsweise mit Biochips, denen große Entwicklungschancen vorausgesagt werden. Biochips – das ist zunächst mal ein Sammelbegriff. Dahinter verbergen sich winzige Laboranordnungen; auf kleinster Fläche eines festen Trägermaterials werden bestimmte Biomoleküle analysiert, vornehmlich DNA oder Proteine.

Und während früher jahrelange Laborversuche notwendig waren, um ein Gen nach dem anderen auf seine Funktion zu

testen, erlauben es die Biochips, eine große Anzahl von Genen auf einmal zu analysieren. Dabei kommt es nicht von ungefähr, dass das Wort Chip aus der Halbleiterindustrie entlehnt wird: Sowohl Mikro- als auch Biochip bergen eine ungeheure Informationsdichte. Während der Computerchip eine Vielzahl von Schaltkreisen und Informationen enthält, werden auf dem Biochip Hunderte von Genen oder Proteinen schachbrettartig in einem Mikroraster (Microarray) angeordnet. Dabei entspricht jeder Rasterpunkt (Spot) einer herkömmlichen Analyse im Reagenzglas. Den Namen Chip rechtfertigt zudem die Herstellungsmethode, die sich zunehmend der Technologien der Halbleiterbranche bedient.

Mit dem weltweit ersten Biochip lassen sich bis zu 400 Gene zeitgleich analysieren

Infineon gehört auf diesem Gebiet zu den Pionieren. Beispielsweise mit dem weltweit ersten Biochip, der nicht auf Glas oder Kunststoff basiert, sondern auf Silizium, dem wohl vertrauten Grundstoff der

Halbleiterindustrie. Ende März kam erstmals ein solcher Chip auf den Markt, den Infineon gemeinsam mit der amerikanischen MetriGenix entwickelt hat und der vornehmlich dazu dienen soll, neue Medikamente zu testen. Dabei werden zehn Mikrometer schmale Poren in das Silizium eingätzt; auf einem Quadratzentimeter Grundfläche lassen sich damit bis zu 400 Gene zugleich analysieren.

Um beispielsweise einen neuen Wirkstoff gegen Brustkrebs zu entwickeln, wird der Chip zunächst mit DNA bestückt, die krankheitstypisch verändert ist. Wie eine Seite eines geöffneten Reißverschlusses wird eine halbe DNA-Doppelhelix in die Poren eingesetzt. Und nun werden die Proben einem potenziellen Wirkstoff ausgesetzt. Der lagert sich im Schlüssel-Schloss-Prinzip an den vorhandenen Strang an (Hybridisierung) – vorausgesetzt, es ist ein komplementäres Stück vorhanden. Ob sich der Reißverschluss gut zugezogen hat, erweist sich in der optischen Probe: Ein Farbstoff wird zugegeben, der sich ausschließlich an die geschlossenen Gen-Paare anlagert. Dabei wird Licht ausgesendet, das grün, rot und gelb fluoresziert und wiederum von einer Präzisionskamera eingefangen wird. Am Computerbildschirm werden die Signalmuster der gesunden mit denen der behandelten Probe verglichen. Stimmen sie überein, hat der Brustkrebs-Wirkstoff angeschlagen.

Das Flow-Thru-Chip-System hat Infineon mit der US-amerikanischen Firma MetriGenix entwickelt. Es umfasst eine Hybridisierungseinheit (links), eine Auswerteeinheit (rechts unten) mit integrierter hochempfindlicher Kamera sowie Biochips, die in einer Cartridge untergebracht sind (im Bild rechts oben), über die die Analyten zugeführt werden.



COMPUTERCHIPS KOMMUNIZIEREN MIT NERVENZELLEN

Klingt nach Science Fiction, ist aber schon sehr real: Einzelne Nervenzellen werden isoliert, auf einen Chip aufgebracht und wachsen dort zu einem neuronalen Netz zusammen, das über mehrere Wochen am Leben erhalten werden kann. Es entsteht ein hybrides System aus einem Halbleiter-Chip und Neuronen. Genau das ist jetzt Infineon-Forschern und Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für Biochemie in München mit den Nervenzellen einer Schnecke gelungen. Sie haben pro Quadratmillimeter Chipfläche 16.384 hoch empfindliche Sensoren aufgebracht, die die schwachen elektrischen Signale der Neuronen – maximal fünf Millivolt – verstärken. Die Signale gehen dann zur Auswertung an ein Computersystem.

Der Infineon-Chip arbeitet dabei mit einem innovativen dreidimensionalen Raster: Ein Netzwerk aus feinen Mikrokanälen durchzieht den Chip von der Ober- bis zur Unterseite. Die Probe wird mehrmals zwischen den Poren hin- und hergepumpt (Flow-Thru-Methode). Das spart Hybridisierungszeit, macht den Test gegenüber planaren Methoden empfindlicher, genauer und spart überdies Proben und teure Reagenzien. Rund 60.000 Euro kostet die komplette Systemlösung „4D Array System“ heute, zu der neben dem Chip selbst auch die Auswerteeinheit samt der hoch empfindlichen CCD-Kamera (Charge Coupled Device) zählt. Für die Pharmaindustrie stehen den Kosten jedoch gewaltige Einsparungen gegenüber: Zwölf bis 15 Jahre dauert es heute, bis ein neues Medikament entwickelt ist. Mit dem Biochip verkürzt sich die Zeit um ein bis zwei Jahre, während sich mit einem erfolgreichen Massenmedikament bis zu 500 Mio. Euro im Jahr umsetzen lassen.

Doch nicht nur in der Medikamentenentwicklung, auch in der Diagnose können

Mithilfe dieser Daten können Neurobiologen analysieren, wie ganze Zellverbände oder einzelne Zellen über einen festgelegten Zeitraum auf elektrische Stimulation oder bestimmte Substanzen reagieren. Die Wissenschaftler versprechen sich von dieser Innovation vor allem neue Erkenntnisse über den Neuronen-Dschungel im menschlichen Gehirn. Mehr als 100 Milliarden Nervenzellen stehen dort in ständigem Informationsaustausch. Ihre Funktionsweise, ihr Zusammenwirken zu verstehen, könnte ein erster Schritt sein, heute unheilbare Krankheiten des Gehirns zu enträtseln.

die Ein-Quadratzentimeter-Biochips schon heute Großes leisten: Mit Flow-Thru-Biochips lassen sich Entzündungen, Brust- und Lungenkrebs untersuchen, darüber hinaus Degenerationserscheinungen des Nervensystems, beispielsweise Alzheimer, Parkinson und Multiple Sklerose. In naher Zukunft sollen standardisierte Systeme verfügbar sein, um Leberkrankheiten, den programmierten Zelltod (Apoptose) und Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersuchen zu können. Und neben diesen Standardlösungen können die Chips nach Kundenwunsch auch individuell konfiguriert werden. Möglich sind damit beispielsweise Lebensmittelforschung und Vaterschaftsanalyse, darüber hinaus gerichtsmedizinische Anwendungen und Prädispositionsdiagnostik ebenso wie Resistenzuntersuchungen.

Biochips könnten die Arbeit in Pharmalabors umfassend verändern

Und damit nicht genug: Infineon-Forscher arbeiten daran, dass künftig beim Arzt eine einfache Blutprobe genügt, um



Mit dem Neuro-Chip bekommen Wissenschaftler ein lang erhofftes Instrument zur Grundlagenforschung an die Hand, das gänzlich neue Einblicke in die Funktionsweise des Gedächtnisses erlaubt. Wahrnehmung, Verarbeitung und Speicherung von Informationen im Gehirn können untersucht werden – mit ungeahnten Möglichkeiten für Anwendungen in Biomedizin, Biotechnologie und Hirnforschung.

bei bestimmten Krankheiten festzustellen, ob ein Medikament wirkt oder nicht, ob Nebenwirkungen zu erwarten sind, mit welchen Reaktionszeiten zu rechnen ist. Das erleichtert die Behandlung gerade für Bluthochdruckpatienten oder Menschen mit Depressionen, bei denen der Zeitfaktor in der Therapie von größter Bedeutung ist.

Insgesamt könnten Biochips die Arbeit in Pharmalabors ähnlich umfassend verändern wie der Personalcomputer vor zwei Jahrzehnten die Computerlandschaft: Alles wird kleiner, schneller, kostengünstiger. Analysen der Freedonia-Gruppe gehen im Markt für Biochips und verwandte Produkte von 32 Prozent jährlichem Wachstum aus. Infineon bringt alle Kernkompetenzen mit, um qualitativ hochwertige Chips in großer Stückzahl preiswert zu produzieren. Gemeinsam mit Partnern aus der Pharmaindustrie sollen Systemlösungen entstehen – damit Infineon eine führende Rolle in diesen Zukunftsmarkt einnimmt.

Weitere Informationen stehen im Internet unter: www.infineon.com/bioscience

EIN WETTLAUF IM SCHWEINEZYKLUS

Wie sich Infineon dafür rüstet, den Hase-und-Igel-Wettlauf am Speicherchipmarkt für sich zu entscheiden – Interview mit Harald Eggers, Leiter des Geschäftsbereichs Speicherprodukte.

Immer dann, wenn die neuesten Geschäftszahlen von Infineon zu beurteilen sind, geht es sehr schnell auch um die jüngsten Entwicklungen am Speicherchipmarkt. Was macht das Geschäft mit diesen Chips eigentlich aus, dass es so gravierend auf die Unternehmensentwicklung durchschlägt?

Harald Eggers:

Der Umsatzanteil, den Infineon mit Speicherchips erwirtschaftet, liegt zwischen 30 und 40 Prozent. Der weitaus größte Teil der verkauften Speicherkapazitäten (auch Megabits genannt), nämlich rund 70 Prozent, wird in PCs eingebaut. Hinzu kommen rund 20 Prozent für Computerinfrastruktur wie Server und Großrechner; mit den restlichen 10 Prozent werden Grafik- und mobile Anwendungen wie Personal Digital Assistants bestückt. Gerade der DRAM-Markt für PCs ist extrem volatil, geprägt von so genannten Schweinezyklen, bei denen Angebot und Nachfrage regelmäßig auseinander klaffen. Auf der Nachfrageseite haben wir es zum einen mit dem so genannten Replacement Cycle zu tun: Hier rechnet man damit, dass die Unternehmen im Abstand von drei bis vier Jahren in neue Computer investieren. Die letzte große Investitionswelle lag kurz vor dem Jahr 2000, als das befürchtete Jahr-2000-Problem zu immensen Computerinvestitionen geführt hatte. Inzwischen glauben wir Anzeichen dafür zu erkennen, dass in der zweiten Jahreshälfte 2003 ein neuer Replacement Cycle beginnt. Der zweite Kreislauf betrifft die private Nachfrage und ist saisonal geprägt: So beschert uns das Weihnachtsgeschäft jedes Jahr ein verhältnismäßig starkes Quartal. Wichtig auf der Nachfrageseite ist zudem, dass die Speichergröße über die Jahre relativ an Bedeu-

tung verloren hat, wenn es um die Computerleistung geht. Die Computerhersteller kalkulieren, dass der Speicherpreis 5 bis 6 Prozent des Computerpreises ausmacht – und bauen je nach Preis mehr oder weniger Chips ein. Bleibt noch die Angebotseite: Sie hängt vornehmlich davon ab, wie viel die Halbleiterhersteller investiert haben. So gesehen hatten wir im Jahr 2001 ein Überangebot, das aus den Investitionen der Branche in den Jahren 1999 und 2000 resultierte, und das auf eine lang anhaltende Nachfrageschwäche prallte. Die war zum einen dem Schweinezyklus geschuldet, zum anderen aber auch der allgemeinen Wirtschaftskrise.

Trotzdem scheinen die Mechanismen im Halbleitermarkt einigermaßen vorhersehbar zu sein. Ließe sich der Kreislauf nicht durchbrechen, etwa indem die Hersteller antizyklisch dann investieren, wenn der Markt schwach ist?

Harald Eggers:

In Grenzen, denn das heißt, dann zu investieren, wenn man gerade aufgrund niedriger Preise Verluste fährt und eigentlich kein Geld hat. Wir haben jedoch genau das getan: Als erstes Halbleiterunternehmen der Welt haben wir in Dresden die Volumenproduktion auf 300-Millimeter-Wafern aufgenommen – und das in der wirtschaftlich schwächsten Zeit. Inzwischen produzieren wir damit günstiger als auf den bisher üblichen 200-Millimeter-Wafern, denn auf die pizzagroße Grundfläche passen etwa zweieinhalb mal so viele Chips, die Produktionskosten liegen bis zu 30 Prozent unter den bisherigen. Zudem liegen wir im so genannten „Shrinking“-Wettbewerb ganz vorn: Immer kleinere Chipstrukturen sorgen für immer

kleinere Chips, und das verbessert unsere Kostenposition und macht uns attraktiver.

Welche Folgen hat das für die Wettbewerbsposition von Infineon?

Harald Eggers:

Man muss ja beachten: DRAM-Chips sind Commodity Produkte – sie unterscheiden sich bei den gleichen technischen Parametern von Hersteller zu Hersteller nicht und sind damit austauschbar. So kann sich ein Produzent nur bedingt über die Qualität abheben, sondern hauptsächlich über Effektivität und Logistik. Und so entsteht ein enormer technologischer Wettlauf um die besten und günstigsten Produktionsmethoden.

Ein Wettlauf, bei dem immer wieder Läufer auf der Strecke bleiben?

Harald Eggers:

Genau das zeichnet sich jetzt wieder ab. Im Moment produzieren die Top-10-Unternehmen fast 95 Prozent der DRAM-Chips weltweit, wobei wir den dritten Rang einnehmen. Aber immer mehr Hersteller können das technologische Entwicklungstempo nicht mehr halten. Während unser Spielraum mit unserer guten Kostenposition wächst und wir im vergangenen Geschäftsjahr Umsatzzuwächse zu verzeichnen hatten, geht anderen die Puste aus. Sie haben angesichts hoher Verluste Investitionen gekürzt und sogar Standorte geschlossen. Aber die eigentliche Konsolidierung steht noch aus, und die geht schleichend vor sich: Investitionen – oder eben Nicht-Investitionen – wirken sich in diesem Markt erst nach etwa zwei Jahren spürbar aus. Die nächste Knappheit ist also schon vorprogrammiert, und Infineon hat

sich dafür Spielraum erarbeitet. Für das Jahr 2005 rechnen wir damit, dass unser Marktanteil auf 20 bis 25 Prozent wächst, während die Zahl der großen Player am Markt auf bis zu vier zusammenschumpft.

Infineon hat vor allem in den vergangenen Quartalen eine ganze Reihe von Kooperationsvereinbarungen mit anderen Chipherstellern, vor allem in Asien, unterzeichnet...

Harald Eggers:

Auch das setzen wir dem zyklischen Marktverlauf entgegen. Gerade unser Pionierstatus bei der 300-Millimeter-Technologie, aber auch unsere besonders guten Kundenbeziehungen und die niedrigen Produktionskosten machen uns als Partner ausgesprochen attraktiv. Wir transferieren unsere Technologien, etwa im Fall der Semiconductor Manufacturing Inter-

national Corporation (SMIC) nach China, oder lizenzieren sie, beispielsweise an den taiwanesischen Chiphersteller Winbond. Im Gegenzug sichern wir uns Abnahmerechte. Damit erweitern wir unsere Kapazitäten für Zeiten steigender Nachfrage, sind aber gleichzeitig flexibler für den Fall von Markteinbrüchen. Zudem teilen wir Risiken in der Entwicklung und bei Investitionen mit unseren Partnern, wie etwa in der Entwicklungs- und Fertigungskooperation mit dem taiwanesischen Speicherhersteller Nanya. Auch in Zukunft werden wir nicht so stark die eigene Fertigung ausbauen, vielmehr wollen wir sie zunehmend jenen überlassen, die mit günstigen und flexiblen Strukturen aufwarten können. Unser eigener Fokus ist ganz klar die Technologieentwicklung. Beispielsweise sorgt eine Innovationsgruppe dafür, dass wir vorn dabei sind, um viel versprechende Trends aufzugreifen.

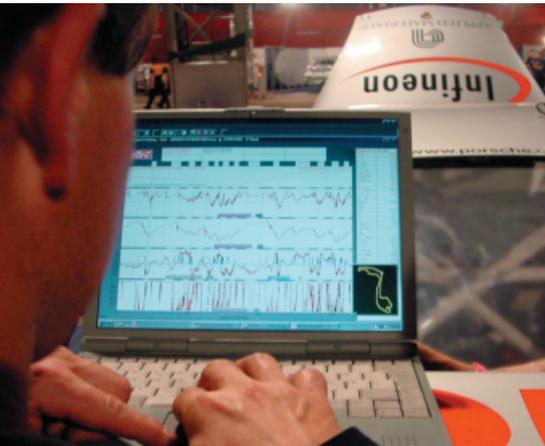
Auch wenn sich der Markt jetzt erholt: Die nächste Halbleiterkrise kommt bestimmt. Ist Infineon dafür gewappnet?

Harald Eggers:

Wir gehen davon aus, dass wir zu den Gewinnern der Marktkonsolidierung gehören und unter den wenigen verbleibenden Halbleiterunternehmen eine Spitzenstellung einnehmen. Dann könnten wir zugleich über ein breiteres Produktportfolio bessere Margen erzielen. Dass wir bereits im Konjunkturtal neue Marktanteile sichern konnten, deutet darauf hin. Hinzu kommt unsere Strategie, uns auf die Technologieentwicklung zu konzentrieren und neue Fertigungskapazitäten mit Partnern aufzubauen – insgesamt dürften wir damit für die Zukunft gut gewappnet sein.

Schweinezyklus: Angebot und Nachfrage treffen sich nicht in einem Punkt. Ein Überangebot sorgt für fallende Preise, Lagerbestände häufen sich an. In der Folge wird die Produktion zurückgefahren, die Unternehmen verlieren Geld und investieren nicht. In der darauf entstehenden Knappheit steigen die Nachfrage und der Preis, es wird mehr produziert und in die Produktionsanlagen investiert, bis erneut ein Überangebot entsteht, und der Kreislauf von vorn beginnt. Erstmals beschrieben wurde das Phänomen tatsächlich im Markt für Schweinehälften.





Infineon ist „Offizieller Lieferant“ des Scuderia Ferrari Marlboro Formel-1-Teams. Ingenieure von Infineon werden mit Ferrari in den Bereichen der elektronischen Motorsteuerung, Telemetrie, elektronischen Stromversorgung, Sensorik und Hochgeschwindigkeitsmessung zusammen arbeiten.

INFINEON „OFFIZIELLER LIEFERANT“ VON FERRARIS FORMEL-1-TEAM

Infineon hat eine weit reichende technische Kooperation mit Ferrari SpA beschlossen und fungiert damit als offizieller Lieferant des Scuderia Ferrari Marlboro Formel-1-Teams. Laut Kooperationsvertrag bringt Infineon während der laufenden Rennsaison seine Spitzen-

technologien für die Automobilelektronik in die Kooperation ein. Außerdem steht Ferrari ein Team erfahrener Renningenieure des Unternehmens zur Seite – mitsamt ihrer Expertise in den Bereichen elektronische Motorsteuerung, Telemetrie, elektronische Stromversorgung, Sensorik und Hochgeschwindigkeitsmessung. Die Partnerschaft mit Ferrari verschafft Infineon mehrere Vorteile. Zum einen ermöglicht sie, Technologien zu entwickeln, die neue Maßstäbe in der Automobilelektronik setzen. Zum anderen können Ideen und Erfahrungen aus dieser Kooperation in zukünftige Produktentwicklungen einfließen. Der Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik von Infineon erzielte in den vergangenen fünf Quartalen jeweils Rekordergebnisse. Schon heute gibt es weltweit in jedem dritten und europaweit in jedem zweiten Auto einen Infineon-Chip in der Motorsteuerung.

INFINEON BESCHLEUNIGT KONZERNUMBAU

Um möglichst bald in die Gewinnzone zurückzukehren, setzt Infineon weiterhin auf massive Einsparungen. Bereits im vergangenen Geschäftsjahr hatte das Unternehmen die beiden Restrukturierungsprogramme Impact und Impact² auf den Weg gebracht, mit denen die Kosten bisher um rund 2,8 Milliarden Euro gesenkt wurden. Jetzt stehen erneut Einsparungen von rund 500 Millionen Euro an, davon 50 Millionen im laufenden Geschäftsjahr. So sollen in den kommenden Monaten bei verschiedenen Zentralfunktionen 500 Stellen gestrichen werden, im Unternehmensbereich Sichere Mobile Lösungen sind 150 Arbeitsplätze weniger geplant. Weitere 250 Jobs sollen mit verschiedenen Konzernfunktionen ausgegliedert oder verlagert werden. Zudem arbeitet Infineon daran, seine Strukturen zu dezentralisieren und damit noch effizienter zu werden: Die Sparte Automobil- und Industrieelektronik wird künftig vom österreichischen Villach aus gesteuert, wo sich heute bereits der Forschungs- und Produktionsstandort des Geschäftsbereichs befindet. Im Sinne der Unternehmensstrategie Agenda 5-to-1 wird zudem die regionale Präsenz in den USA und in Asien weiter ausgebaut. In Singapur wurde im April der Grundstein für ein neues Gebäude der künftigen Asienzentrale gelegt; in den USA wird neben dem bisherigen Standort San Jose, Kalifornien, ein weiterer Standort an der Ostküste entstehen. Um Kosten zu sparen, erwägt der Konzern zudem zur Zeit die mögliche Verlagerung des Konzernsitzes von München ins Ausland, wobei mehrere Standorte in Asien, Amerika und Europa in Betracht gezogen werden, unter anderem die Schweiz. All das, so Infineon-Chef Schumacher, sei dem obersten Ziel untergeordnet, in die Gewinnzone zurückzukehren. Weitere Informationen stehen im Internet unter: www.infineon.com/news

MATTHIAS POTH NEUER LEITER DES CORPORATE CENTER

Im Februar dieses Jahres hat Matthias Poth (38) die Leitung des Corporate Center (CPC) von Infineon übernommen. Das CPC, das weltweit 250 Mitarbeiter zählt, umfasste bisher acht Bereiche, vom Business Development über das Center of Organizational Excellence hin zum Bereich Strategie; hinzu kommen die Bereiche Sicherheit ebenso wie Mobilität & Service, daneben Prozesse & Kultur, Relationship Management sowie Intellectual Capital. Mit Matthias Poth soll das CPC stärker serviceorientiert ausgerichtet und neu organisiert werden; in seinen Zuständigkeitsbereich aufgenommen wurden zusätzlich die drei Kommunikationsabteilungen Communications, Branding & Marketing sowie Investor Relations.



JOINT VENTURE SOLL WEG IN WACHSTUMSMARKT FLASH-SPEICHER EBENEN

Infineon Technologies Flash GmbH & Co. KG ist der Name eines neuen Joint Venture, das Infineon mit dem israelischen Unternehmen Saifun Semiconductors gegründet hat. Ziel des Gemeinschaftsunternehmens mit Hauptsitz in Dresden ist es, das Geschäft mit nicht flüchtigen Speichern deutlich auszubauen. Marktforschungsunternehmen rechnen in diesem Markt bis 2006 weltweit mit einem jährlichen Wachstum von 10 Prozent. Infineon Flash geht aus dem bereits seit 2001 bestehenden Joint Venture Ingentix hervor, das vor allem auf die Entwicklung von Daten-Flash-Speichern konzentriert war. Die Wachstumserwartungen stützen sich dabei wesentlich auf den vermehrten Einsatz von Mobiltelefonen sowie die steigende Nachfrage nach portablen Geräten (z. B. MP3-Player) und Digitalkameras mit integrierten und mobilen Speichern, die auch ohne Betriebsspannung ihren Inhalt behalten. Parallel dazu sieht sich Infineon durch das Joint Venture in der Lage, sein DRAM- und Flash-Know-how in innovativen neuen Produktgenerationen zu bündeln. Im Sinne der Unternehmensstrategie Agenda 5-to-1 wird Infineon damit als Anbieter von Systemlösungen weiter an Profil gewinnen. Die Volumenproduktion der ersten Daten-Flash-Speicher soll in der zweiten Jahreshälfte 2003 beginnen, die der ersten Programm-Flash-Speicher Anfang des Folgejahres.

HERAUSRAGENDE ERGEBNISSE VON INFINEON-FORSCHERN

Auf der International Solid-State Circuits Conference (ISSCC 2003) konnten Infineon-Forscher unlängst zahlreiche technologische Durchbrüche präsentieren. Auf dem globalen Technologie-Forum zu neuesten Entwicklungen bei Halbleitern und System-on-Chips wurden Fortschritte für neue Applikationen für CMOS-Chip-Technologien vorgestellt, darunter auch Biochips, daneben flexible organische Schaltungen und intelligente Textilien. Darüber hinaus zeigte Infineon Innovationen im Bereich der High-Speed-Kommunikation auf der Basis von Silizium-Germanium-Transistoren: Mit der Entwicklung von Multiplexer-/Demultiplexer-Schaltungen, die Datenraten von bis zu 40 Gigabit pro Sekunde auf einer Leitung erreichen, wurde ein neuer Maßstab für die Chip-to-Chip-Kommunikation gesetzt.

LEISTUNGSSPRUNG: NEUER VDSL-CHIPSATZ MIT HOHEN DATENRATEN

Einen wesentlichen Technologiefortschritt, der ohne zusätzliche Kosten für die Nutzer auskommt, stellt der neue VDSL-Chipsatz VDSL5100 von Infineon dar. Der neu entwickelte Chipsatz ist für alle VDSL-Applikationen ausgelegt, unterstützt also sowohl Ethernet als auch ATM VDSL.

PROBELAUF FÜR CHIP-STRUKTUREN UNTER 50 NANOMETERN

In einem Reinraum des firmeneigenen Forschungslabors in Erlangen hat Infineon einen Prototypen des ersten kommerziell verfügbaren EUV-Labor-Belichtungssystems installiert. EUV steht für Extreme Ultra Violet und bezeichnet ein neuartiges Lithographie-Verfahren, das der Fertigung der übernächsten Chip-Generationen mit Strukturen von 50 Nanometern und kleiner zum Durchbruch verhelfen soll. Die EUV-Lithographie arbeitet mit extrem kurzen Wellenlängen von nur 13,5 Nanometern und liegt damit weit unterhalb der Wellenlängen herkömmlicher optischer Lichtquellen, z. B. heute 193 nm. Das Laborsystem, das gemeinsam mit der AIXUV GmbH – einem Spin-Off des Fraunhofer Institutes für Lasertechnologie – entwickelt wurde, besteht aus einer Gasentladungslampe, die EUV-Strahlung im Spektralbereich von 9 bis 20 Nanometern erzeugt. Sie stellt einen Meilenstein in der Prozessentwicklung der EUV-Technologie dar. Diese gilt weltweit als favorisiertes Verfahren, wenn es um die weitere Verkleinerung der Schaltkreisstrukturen geht. Internationalen Prognosen zufolge wird der Beginn der Volumenfertigung mit 50-Nanometer-Technologie für das Jahr 2007 erwartet.

Das Produkt verfügt über wesentlich verbesserte Datenraten: Dank eines schnelleren internen Daten-Clocks und der Vorteile der 0,13-Mikrometer-Prozesstechnologie erreicht die mittlerweile fünfte Generation der QAM-VDSL-Chips von Infineon eine kumulierte Datenrate von mehr als 100 Megabit pro Sekunde. Diese hohe Leistungsfähigkeit ermöglicht es Service-Providern, ein größeres Spektrum an Diensten mit hohen Bandbreiten anzubieten, etwa Filme, hoch auflösendes Fernsehen und Spiele.

ERNEUT UMSATZANTEILE GEWONNEN

QUARTALSERGEBNISSE:

RÜCKGANG BEI SPEICHERPREISEN DRÜCKT AUF DAS EBIT

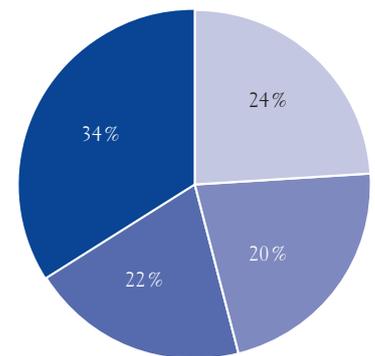
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres hat Infineon seinen Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 3 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro steigern können; gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren es 13 Prozent mehr. Vor allem bei den Speicherprodukten ist der Umsatz gestiegen; daneben ist im Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik erneut ein Rekordumsatz zu vermelden. Wiederholt ist es Infineon gelungen, sich in einem schwierigen Umfeld weitere Marktanteile zu sichern.

Andererseits sorgte vor allem der erneute Preisrückgang bei Speicherprodukten, aber auch in anderen Segmenten, trotz gesteigerter Produktivität für einen höheren Nettoverlust. Dieser lag bei 328 Millionen Euro gegenüber einem Nettoverlust von 40 Millionen Euro im Vorquartal und 108 Millionen Euro im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2002. Darin enthalten sind, wie bereits in den vergangenen beiden Quartalen berichtet, Wertberichtigungen auf latente Steuern in Höhe von 103 Millionen Euro und Sondereffekte von 54 Millionen Euro, hervorgerufen durch Abschreibung auf Lagerbestände, einmalige Lizenzeinnahmen, Restrukturierungskosten und akquisitionsbedingte Aufwendungen. Ohne diese Sondereffekte hätte der Nettoverlust bei 171 Millionen Euro gelegen.

Der Quartalsverlust pro Aktie betrug 0,45 Euro, gegenüber einem Verlust pro Aktie von 0,06 Euro im vorausgegangenen Quartal und 0,16 Euro im vergleichbaren Vorjahresquartal. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag im abgelaufenen Quartal bei minus 223 Millionen Euro, gegenüber minus 31 Millionen Euro im Vorquartal und minus 176 Millionen Euro im zweiten Quartal 2002.

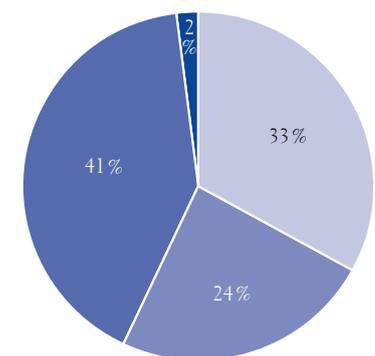
Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen lagen bei 254 Millionen Euro oder 17 Prozent vom Umsatz; im Vergleich zum Vorquartal mit 265 Millionen Euro gingen sie damit leicht zurück. Erneut gesenkt wurden die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten; sie schlugen mit 164 Millionen Euro oder 11 Prozent vom Gesamtumsatz zu Buche, im vorausgegangenen Quartal waren es noch 172 Millionen Euro oder 12 Prozent vom Gesamtumsatz. Bei 1,5 Milliarden Euro gegenüber 1,6 Milliarden Euro im vorausgegangenen Quartal lag die Brutto-Cash-Position. Der freie Cashflow aus den laufenden Geschäfts- und Investitionstätigkeiten, ohne Kauf oder Verkauf von frei verfügbaren Wertpapieren des Umlaufvermögens, verbesserte sich auf minus 90 Millionen Euro, gegenüber minus 362 Millionen Euro im Vorquartal.

Regionale Umsatzverteilung in Prozent für das Quartal zum 31.03.03



- Deutschland
- Restliches Europa
- Amerika (NAFTA)
- Asien/Pazifik

Segment-Umsatzerlöse in Mio. Euro für das Quartal zum 31.03.03



- Kommunikation: 488 Mio. Euro
- Automobil- und Industrieelektronik: 354 Mio. Euro
- Speicherprodukte: 609 Mio. Euro
- Sonstige und Konzernfunktionen: 33 Mio. Euro

Infineon: 1.484 Mio. Euro

Außerhalb Europas wurden 56 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet, gegenüber 55 Prozent im Vorquartal; vor allem in Asien einschließlich Japan konnte mehr abgesetzt werden. Zum 31. März 2003 beschäftigte Infineon weltweit ca. 31.200 Mitarbeiter, davon etwa 5.500 in Forschung und Entwicklung.

Bezogen auf die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2003 lag der Gesamtumsatz mit 2,93 Milliarden Euro um 28 Prozent über dem im vergleichbaren Vorjahreszeitraum (2,28 Milliarden Euro), der Nettoverlust betrug 368 Millionen Euro gegenüber 439 Millionen Euro im ersten Vorjahreshalbjahr. Die Steueraufwendungen für das erste Halbjahr enthalten Wertberichtigungen in Höhe von 125 Millionen Euro für latente Steuern, gemäß US-GAAP-Anforderungen. Das EBIT für das erste Halbjahr lag bei minus 254 Millionen Euro, gegenüber einem EBIT von minus 735 Millionen Euro in der ersten Hälfte des vergangenen Geschäftsjahres.

Rekordumsätze vermeldet erneut der Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik: Um 6 Prozent über dem Vorquartal und 18 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum lag er bei 354 Millionen Euro. Mehr umgesetzt wurde in erster Linie mit Kfz-Leistungshalbleitern und mit Netzteil- und Stromversorgungsprodukten. Das EBIT stieg auf 49 Millionen Euro, im Vorquartal waren es 44 Millionen Euro, im vergleichbaren Vorjahreszeitraum 24 Millionen Euro. Gründe waren, dass die Produktivität gesteigert werden konnte und die Produktion der Leistungshalbleiter zunehmend auf größere, 200 Millimeter breite Siliziumscheiben umgestellt wurde. Insbesondere in Asien stieg der Marktanteil für Netzteil- und Stromversorgungs-Applikationen hauptsächlich für den Computerbereich. Verbessert wurde zudem die Marktposition bei Kfz-Leistungshalbleitern, vor allem für Produkte für Antriebsstränge und Komfortanwendungen.

QUARTALS-KONZERN-GEWINN- UND-VERLUSTRECHNUNG	3 MONATE ZUM	
	31.12.02	31.03.03
	in Mio. Euro	
Umsatzerlöse	1.441	1.484
Umsatzkosten	-1.039	-1.283
Bruttoergebnis vom Umsatz	402	201
Forschungs- und Entwicklungskosten	-265	-254
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	-172	-164
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	-1	-10
Sonstige betriebliche Erträge, Saldo	-7	-
Betriebsergebnis	-43	-227
Zinsergebnis	1	-11
Anteiliger Überschuss (Fehlbetrag) von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	16	7
Sonstige Erträge (Aufwendungen), Saldo	-4	-3
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	2	2
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-28	-232
Erträge (Aufwendungen) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-12	-96
Konzernüberschuss (-fehlbetrag)	-40	-328
Gewichtete Anzahl ausstehender Aktien – Basis und verwässert	721	721
Konzernüberschuss (-fehlbetrag) je Aktie – Basis und verwässert	-0,06	-0,45
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-31	-223

Auch der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation steigerte den Umsatz um 6 Prozent gegenüber dem Vorquartal und um 17 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 112 Millionen Euro. Und auch hier kommen die Wachstumsimpulse aus Asien – vor allem mit höheren Umsätzen bei Breitbandzugangstechnologie wie Ethernet-over-VDSL-Zugangstechnologie und bei ADSL-Technologie der nächsten Generation für Vermittlungsstellen. Damit zahlt sich diese neue Ausrichtung des Infineon Produktportfolios aus. Auch das EBIT verbesserte sich, hauptsächlich durch Kosteneinsparungen, auf minus 39 Millionen Euro. Im Vorquartal waren es minus 42 Millionen Euro; im zweiten Quartal des

Geschäftsjahres 2002 minus 66 Millionen Euro. Eingeführt wurde eine neue Produktfamilie intelligenter Glasfaser-Transceiver, hinzu kamen erste Muster neuartiger 10G-XPAK-Transceiver, die an führende Unternehmen im Glasfasermarkt ausgeliefert wurden.

Einen Umsatzrückgang um 9 Prozent auf 376 Millionen Euro musste der Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen hinnehmen, vor allem wegen der saisonalen Nachfrageschwäche bei Mobiltelefonen, die dem Weihnachtsgeschäft erwartungsgemäß gefolgt ist. Gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum lag der Umsatz allerdings um 27 Prozent höher.

AUSGEWÄHLTE
KONZERN-BILANZDATEN

	ZUM	
	30.09.02	31.03.03
	in Mio. Euro	
Aktiva		
Zahlungsmittel	1.199	633
Wertpapiere des Umlaufvermögens	738	842
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	758	735
Vorräte	891	957
Umlaufvermögen	4.191	3.863
Sachanlagen	4.491	4.248
Bilanzsumme	10.918	10.227
Passiva		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristig fällige Bestandteile langfristiger Finanzverbindlichkeiten	120	109
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.197	858
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.383	2.120
Langfristige Finanzverbindlichkeiten, ohne kurzfristig fällige Bestandteile	1.710	1.698
Verbindlichkeiten	4.760	4.526
Eigenkapital	6.158	5.701

Das EBIT verbesserte sich, vor allem durch Produktivitätssteigerungen, auf minus 23 Millionen Euro – von minus 28 Millionen Euro im Vorquartal und minus 37 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Verlust selbst entsteht im Wesentlichen aus dem geringeren Umsatzvolumen, neben Mobilfunkgeräten auch bei drahtloser Infrastruktur; hinzu kommt starker Preisdruck im Markt für diskrete Bauelemente und Sicherheits-Controller. Gleichzeitig hat Infineon stark in die Forschung und Entwicklung von Software und Referenzdesigns investiert, um zunehmend Systemlösungen anbieten zu können. Auf dem 3GSM World Congress hat Infineon eine komplette UMTS/EDGE-Lösung vorge-

stellt. Mit Agere besteht eine Allianz, um schnelle drahtlose Netzwerklösungen zu entwickeln; die beiden Unternehmen wollen im dritten Quartal die ersten Muster der bisher am höchsten integrierten Dualband-Multimode-Lösung für WLAN-Systeme ausliefern. Im Wachstumsmarkt für Bluetooth-Chips konnte Infineon bis heute über 20 Millionen Stück ausliefern.

Im Geschäftsbereich Speicherprodukte ist mit 609 Millionen Euro ein deutliches Umsatzplus von 12 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu verzeichnen; 4 Prozent mehr waren es gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Enthalten sind hier früher zurückgestellte Lizenzeinnahmen

von 60 Millionen Euro. Das EBIT hingegen lag bei minus 138 Millionen Euro, gegenüber einem positiven EBIT von 29 Millionen Euro im Vorquartal und einem Minus von 33 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahresquartal. Darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 128 Millionen Euro für Lagerbestände von Speicherprodukten. Infineon konnte einerseits seine Produktivität insbesondere in der Speicherfertigung steigern – vor allem durch die 300-Millimeter-Produktion in Dresden, wo schneller als geplant über 6.000 Wafer-Starts pro Woche erreicht werden. Dem stand jedoch der starke Preisrückgang für Speicherprodukte gegenüber. Bei 256-MB-DDR-Modulen, dem Produkt mit dem größten Absatzvolumen, sank der Marktpreis von 6 US-Dollar Anfang Januar auf einen Tiefstand von unter 3 US-Dollar Ende Februar. Zum Quartalsende erholte sich der Preis leicht auf etwas über 3 US-Dollar (Quelle: DRAM Exchange). Sein Fertigungsnetzwerk hat Infineon um eine Vereinbarung mit der Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) in China erweitert. Infineon stellt SMIC seine 0,11-Micron-DRAM-Trench-Technologie und sein Know-how in der 300-Millimeter-Produktion zur Verfügung. Dadurch steigt die Gesamtproduktionskapazität von Infineon um etwa 58.000 Wafer-Starts pro Monat, sobald die vollständige Volumenproduktion bei SMIC wie geplant 2005 erreicht ist. Zudem hat Intel im abgelaufenen Quartal Infineon's DDR-I-400-Modul-Plattform (128 MB, 256 MB und 512 MB) zertifiziert.

AUSGEWÄHLTE DATEN DER
QUARTALS-KAPITALFLUSSRECHNUNG

	3 MONATE ZUM	
	31.12.02	31.03.03
	in Mio. Euro	
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4	101
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-340	-323
Mittelzu(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	-12	4
Abschreibungen	353	359
Mittelabfluss für Sachanlagen	309	230

ZUR WEITEREN STÄRKUNG DER FINANZKRAFT: INFINEON BEGIBT WANDELANLEIHE

Um seine Finanzkraft weiter zu stärken und die langfristige Strategie zu unterstützen, hat Infineon am 30. April eine siebenjährige Wandelanleihe im Volumen von rund 700 Millionen Euro begeben. Das Papier ist in bis zu 68 Millionen Aktien des Unternehmens wandelbar oder kann entweder in bar oder in einer Kombination Aktie und bar zurückgezahlt werden, je nach Maßgabe von Infineon. In den ersten drei Jahren ist die Wandelanleihe, die über die niederländische Tochter Infineon Technologies Holding B.V. platziert wurde, nicht kündbar. Dabei macht sich das Unternehmen die derzeit günstigen Finanzierungsbedingungen im Markt für Wandelanleihen zunutze, resultierend aus niedrigen Zinsen und hohen Aktienkurschwankungen. Durchgeführt wird die Transaktion von Goldman Sachs International und Morgan Stanley; platziert wird sie bei institutionellen Anlegern außerhalb der USA.

WANDELANLEIHE*

Räumt dem Eigentümer das Recht ein, die Anleihe innerhalb einer bestimmten Frist unter gegebenenfalls bestimmten Bedingungen und in einem festen Umwandlungsverhältnis in Aktien des Unternehmens zu tauschen. Da mit dem Wandlungsrecht keine Wandlungspflicht verbunden ist, bietet sich dem Anleger die Chance, bei entsprechender Kursentwicklung an der Substanz und Ertragskraft sowie den Kursgewinnen eines Unternehmens zu partizipieren. Verläuft die Kursentwicklung negativ, verzichtet der Wandelanleihenbesitzer auf sein Wandelrecht und erhält den festen Zins der Anleihe. Wegen des Vorteils der Wandlungsmöglichkeit haben Wandelanleihen in der Regel eine niedrigere Verzinsung als normale Anleihen.

Eine Sonderform der Wandelanleihen bildet die Optionsanleihe, insofern die aus der Anleihe erwachsene Schuldverschreibung auch dann weiterbesteht, wenn das mit den dieser Anleihe beigegebenen Optionsscheinen verbundene Bezugsrecht ausgeübt wird.

Weitere Finanzbegriffe werden im FAZ-Börsenlexikon im Internet unter: www.boersenlexikon.de erläutert.

*Quelle: www.boersenlexikon.de

INFINEON STÄRKT SENSORENGESCHÄFT DER AUTOMOBILSPARTE

Mit der geplanten freundlichen Übernahme von SensoNor ASA, einem führenden Anbieter von Reifendruck- und Beschleunigungssensoren, will Infineon bei Reifendruckensensoren zum weltweiten Marktführer aufsteigen. Dafür haben wir den Aktionären des Unternehmens mit Sitz in Horten, Norwegen, am 20. Mai ein entsprechendes Übernahmeangebot gemacht. Gleichzeitig führt SensoNor eine Barkapitalerhöhung durch und gibt neue Aktien an Infineon aus. Für die gesamte Transaktion wird Infineon rund 48 Millionen Euro zahlen.

„Damit setzen wir konsequent die Strategie um, unsere führende Position im Automotive-Sektor weiter zu stärken und werden unseren Marktanteil bei Halbleitersensoren für die Autoindustrie auf rund 15 Prozent verdoppeln“, sagte Dr. Reinhard Ploss, Leiter des Geschäftsbereiches Automobil- und Industrieelektronik von Infineon.

Laut Marktforschern wächst dieses Segment derzeit jährlich um bis zu 20 Prozent. Größter Wachstumstreiber bei den Drucksensoren sind Sensoren für die

Reifendruckkontrolle. Autohersteller werden aufgrund entsprechender Auflagen ab Ende 2003 rund 10 Prozent der in den USA zugelassenen Neufahrzeuge mit Reifendruckkontrollsystemen ausrüsten, in 2004 wird der Ausrüstungsgrad auf etwa 35 Prozent steigen, in 2005 auf 65 Prozent.

Die Reifendruckensensoren von SensoNor sind bereits bei führenden Herstellern voll qualifiziert, mit denen zum Teil langfristige Lieferverträge bestehen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1985 gegründet und beschäftigt 170 Mitarbeiter.

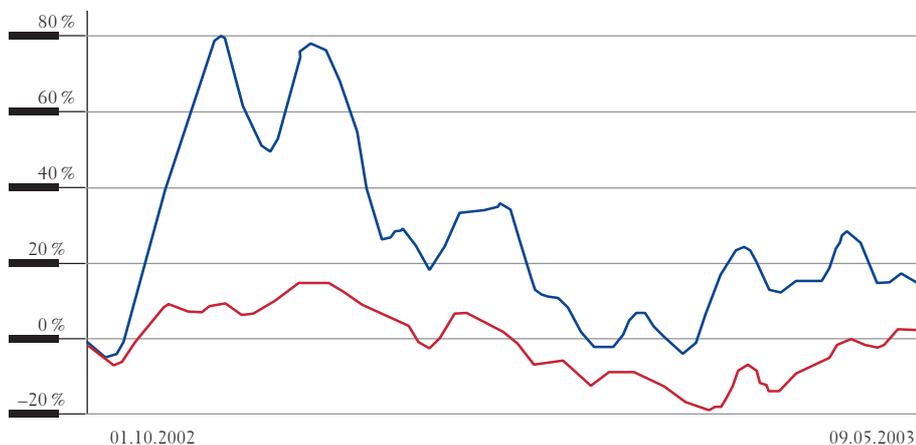
AUSBLICK AUF DIE ZWEITE HÄLFTE DES GESCHÄFTSJAHRES BIS 30.09.

Die weltweite Wirtschaftslage ist nach wie vor schwierig, Prognosen sind somit weiterhin schwer zu treffen. In den vergangenen drei Monaten hat sich die Nachfrage in den meisten Geschäftssegmenten positiv entwickelt; Infineon erwartet, dass dieser Trend in allen Zielmärkten anhält. Um dem anhaltenden Preisdruck gegenzusteuern, setzt Infineon darauf, die Produktivität zu steigern, Kosten zu senken und Restrukturierungsprogramme ebenso umzusetzen wie die neue Unternehmensstrategie Agenda 5-to-1. Im Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen erwartet Infineon, dass die Nachfrage nach GSM/GPRS-Mobilfunkgeräten weiter leicht ansteigt, was sich wiederum positiv auf die Nachfrage nach Bluetooth-Produkten auswirken kann. Bei diskreten Halbleitern ist

auch weiterhin mit schwierigen Marktbedingungen und starkem Preisdruck zu rechnen. Für die drahtgebundene Telekommunikationsinfrastruktur prognostizieren Branchenanalysten für 2003, dass die weltweiten Investitionsausgaben um 5 Prozent zurückgehen – allerdings mit regionalen Unterschieden, etwa einem leichten Wachstum in Europa. Im Glasfasergeschäft rechnet Infineon einerseits mit anhaltendem Preisdruck, andererseits mit einer steigenden Nachfrage nach Breitbandzugangstechnologie (ADSL, VDSL) insbesondere in Asien und Japan. Anhaltender Preisdruck bleibt auch in den Bereichen Automobilelektronik und Kfz-Halbleiter zu erwarten. Dennoch rechnet Infineon mit wachsenden Marktanteilen, vor allem durch weiter steigende Produk-

tivität und ein gutes Portfolio sowohl für Kfz-Leistungshalbleiter als auch für Netzteil- und Stromversorgungsprodukte. Im aktuellen dritten Quartal konnte Infineon eine stark gestiegene Nachfrage nach Speicherprodukten seitens der Original Equipment Manufacturer verzeichnen; die Transparenz im DRAM-Markt bleibt jedoch nach wie vor niedrig.

Relative Performance der IFX-Aktie seit Beginn des GJ 02/03 (auf Basis der Wochen-Schlusskurse, geglättet)



■ INFINEON TECHNOLOGIES (XETRA)			■ DAX (XETRA)		
HOCH	06.11.02	12,08 EURO	HOCH	02.12.02	3.476,83
TIEF	09.10.02	5,03 EURO	TIEF	12.03.03	2.188,75
SCHLUSS	09.05.03	6,68 EURO	SCHLUSS	09.05.03	2.956,59

Hinweis:

Dieses Dokument enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Infineon beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u. a.: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Infineon ist weder geplant noch übernimmt Infineon die Verpflichtung dazu.

INFINEON KALENDER

- 22.07.03 Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal und die ersten 9 Monate (bis 30. Juni) des Geschäftsjahres 2003
- 19.11.03 Jahrespressekonferenz 2003, Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2003 inkl. des 4. Quartals (bis 30. September 2003)

- 20.01.04 Hauptversammlung/ München

Messen und Ausstellungen

- 08.11.03 Münchner Börsentag 2003/ München

IMPRESSUM INVESTOR NEWSLETTER 5/2003

Herausgeber

Infineon Technologies AG
Investor Relations und
Finanzkommunikation
Postfach 80 09 49
81609 München

Tel.: +49 89 234-26655

Fax: +49 89 234-9552987

E-Mail: investor.relations@infineon.com

www.infineon.com/boerse

Redaktion

Katja Bürkle, Verena Raab,
Achim Schneider (verantwortlich)